
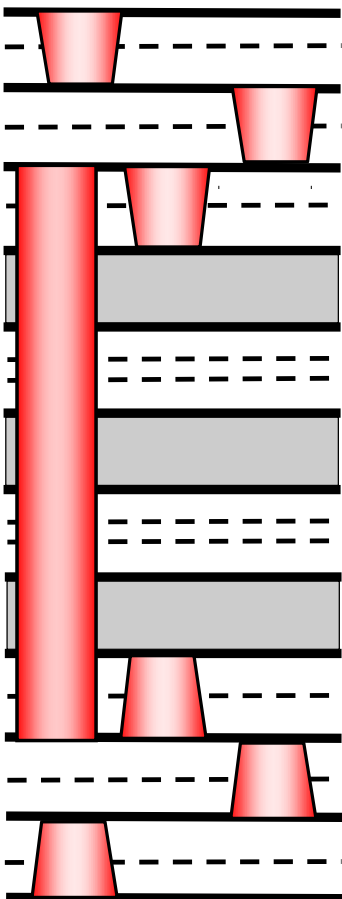


LAGENAUFBAU HDI (Standard)													
HDI12_3+6(8b)+3_1,55_35		12 - Lagen Kerne: 0,20 mm Cu 35/35 µm											
WE-Artikel Nr.:		3 + 6(8B) + 3			vorl. nur CBT Schopfheim								
KUNDE:													
LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU			BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG				
KUNDE	WE							[µm]	[µm]				
1	TOP/VS				Folie	12 µm	1)	12					
									1 x 1080	60			
2	VSK2				Folie	12 µm		30					
									1 x 1080	60			
3	VSK1				Folie	9 µm		30					
									1 x 1080	60			
4	2					35 µm		33					
					0,200 mm			200					
5	3					35 µm		33					
									2 x 1080	124			
6	4					35 µm		33					
		0,200 mm			200								
7	5		35 µm		33								
						2 x 1080	124						
8	6		35 µm		33								
		0,200 mm			200								
9	7		35 µm		33								
						1 x 1080	60						
10	RSK1		9 µm		30								
						1 x 1080	60						
11	RSK2	Folie	12 µm		30								
						1 x 1080	60						
12	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12								
					1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm								
Gesamtdicke Material:								1550					
Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)													
MATERIALDICKE:		1,55	+/-	0,13	mm	Datum:		Bearbeiter:					
DICKE über galv. Endoberfläche		1,64	+/-	0,16	mm								
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer		1,70	+/-	0,18	mm								
Kundenforderung:			+/-		mm	Messstelle:							
Erstellt am		von		Geprüft am		von		Freigegeben am		von		Revision	
29.03.2006		S. Keller		04.05.2006		M.Kress		04.05.2006		R.Schönholz		00 Seite: 19+	